

THERMOCHIP WF

by CUPA GROUP

O PRIMEIRO PAINEL SANDWICH PRÉ-FABRICADO COM FIBRA DE MADEIRA



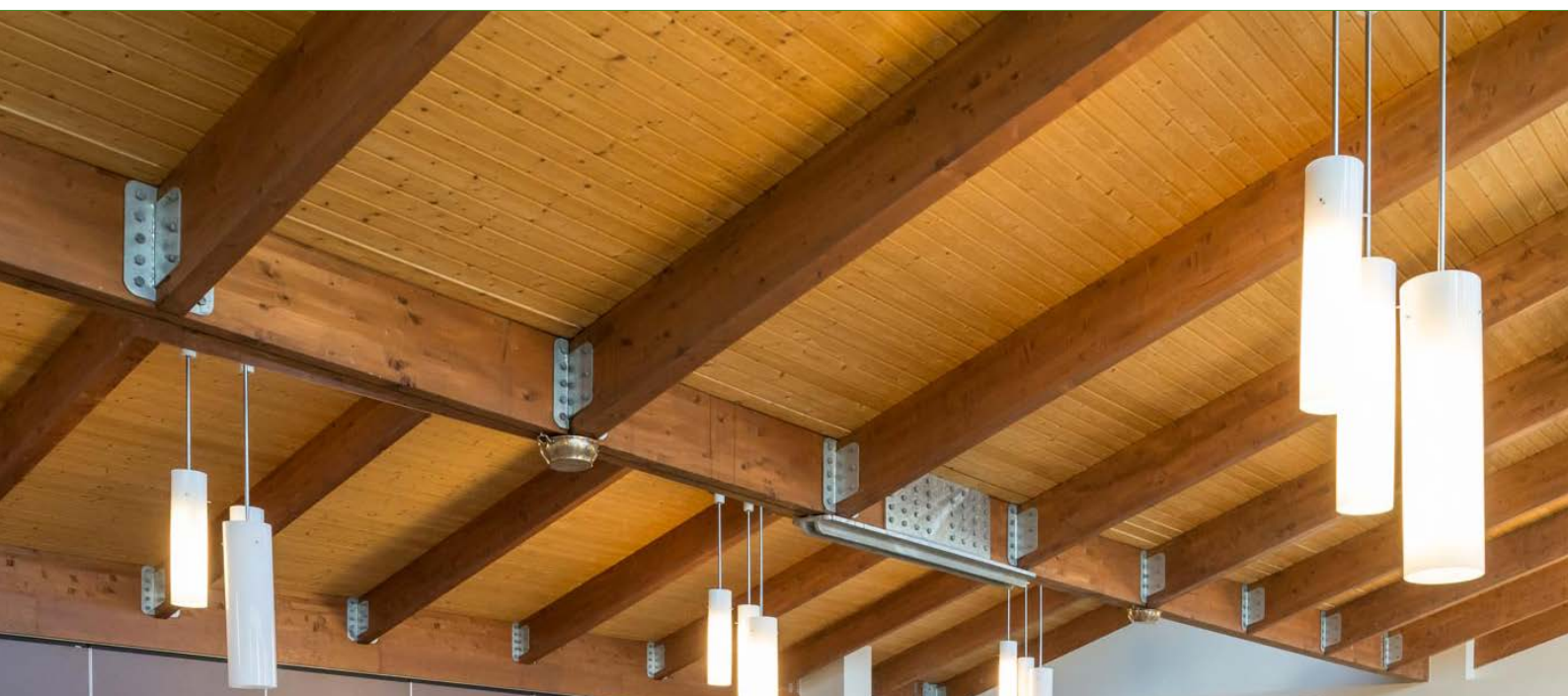
THERMOCHIP

THERMOCHIP WF



O PRIMEIRO PAINEL SANDWICH PRÉ-FABRICADO COM FIBRA DE MADEIRA

Um sistema construtivo desenhado para o futuro da construção eficiente e da arquitetura sustentável



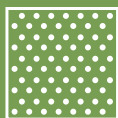
Ecológico e sustentável

Feito exclusivamente de madeira, livre de substâncias nocivas



Eficiência energética

Alta redução do consumo energético da edificação.



Barreira de vapor de difusão variável

Melhor salubridade graças à barreira de vapor incorporada



Sistema macho/fêmea

Um sistema macho/fêmea para uma montagem sem linguetas



Segurança

Garante coberturas mais estáveis e homogêneas que os sistemas tradicionais



Poupança em custos

Maior rapidez na instalação do que com os sistemas tradicionais

COMPOSIÇÃO

THERMOCHIP WF

■ Barreira de vapor de difusão variável

Uma lâmina de barreira de vapor de difusão variável que oferece uma regulação e proteção elevada face à humidade.

■ Acabamentos em madeira natural

O tabuleiro interior do painel tem o valor acrescentado na estética. Dispõe de várias opções decorativas: estrados de abeto, painéis lamelados de abeto e painéis de O.S.B.3.

■ Fibra de madeira

Responde às maiores exigências em isolamento. É ecológica e sustentável. Resulta um clima agradável e conforto acústico alto.

■ Painel O.S.B.3

Formado por partículas longas e orientadas de choupo, compactadas entre si a uma pressão e temperatura adequadas. É um painel de altas prestações mecânicas.

THERMOCHIP WF

TAO

Um painel que oferece a possibilidade de construir coberturas ligeiras com o valor acrescentado do estrado de madeira.

COMPOSIÇÃO

Face interior	Estrado de abeto sem envernizar
Núcleo	Fibra de madeira + Lâmina de vapor
Face exterior	Painel de O.S.B.3
Dimensões	Comprimento: 2500 mm Largura: 550 mm



Opções de acabamentos: sem verniz, velatura (natural, branco, carvalho, castanheiro, nogueira, nogueira clássica, ébano, wengué) e ignífugo.

DADOS TÉCNICOS

Face interior (mm)	Espessura fibra de madeira (mm)	Face exterior (mm)	Grossura (mm)	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Painéis / palete	m ² painel / palete	Peso painel (kg/m ²)	Carga máxima (kg/m ²)	Carga a L/200 (kg/m ²) ^[1]	Transmit. térmica (W/m ² °C)
19	80	15	114	2500	550	20	27,500	31,400	2677	483	0,420
19	100	15	134	2500	550	16	22,000	34,300	2701	503	0,356
19	120	15	154	2500	550	14	19,250	37,200	2740	526	0,305

^[1] Cálculos obtidos em ensaio realizado com distância em apoios a 600 mm.

THERMOCHIP WF

TAO LT

Composto por um painel lamelado de abeto, suporta cargas mais pesadas e estruturas complexas.

COMPOSIÇÃO

Face interior	Painel lamelado de abeto
Núcleo	Fibra de madeira + Lâmina de vapor
Face exterior	Painel de O.S.B.3
Dimensões	Comprimento: 2500 mm Largura: 550 mm



Opções de acabamentos: sem verniz, velatura (natural, branco, carvalho, castanheiro, noqueira, noqueira clássica, ébano, wengué) e ignífugo.

DADOS TÉCNICOS

Face interior (mm)	Espessura fibra de madeira (mm)	Face exterior (mm)	Grossura (mm)	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Painéis / palete	m ² painel / palete	Peso painel (kg/m ²)	Carga máxima (kg/m ²)	Carga a L/200 (kg/m ²) ^[1]	Transmit. térmica (W/m ² °C)
10	80	15	105	2500	550	22	30,250	28,100	2700	488	0,420
10	100	15	125	2500	550	18	24,750	29,900	2725	510	0,356
10	120	15	145	2500	550	16	22,000	33,800	2764	538	0,305

^[1] Cálculos obtidos em ensaio realizado com distância em apoios a 600 mm.

THERMOCHIP WF

TOO

Está formado na sua Face interior por um painel de lascas orientadas O.S.B.3 ótimo para todo o tipo de aplicações.

COMPOSIÇÃO

Face interior	Painel de O.S.B.3
Núcleo	Fibra de madeira + Lâmina de vapor
Face exterior	Painel de O.S.B.3
Dimensões	Comprimento: 2500 mm Largura: 550 mm



DADOS TÉCNICOS

Face interior (mm)	Espessura fibra de madeira (mm)	Face exterior (mm)	Grossura (mm)	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Painéis / palete	m ² painel / palete	Peso painel (kg/m ²)	Carga máxima (kg/m ²)	Carga a L/200 (kg/m ²) ^[1]	Transmit. térmica (W/m ² °C)
15	80	15	110	2500	550	20	27,500	28,400	2646	478	0,428
15	100	15	130	2500	550	18	24,750	31,300	2669	500	0,365
15	120	15	150	2500	550	14	19,250	34,200	2707	519	0,317

^[1] Cálculos obtidos em ensaio realizado com distância em apoios a 600 mm.

INSTALAÇÃO

1

Colocação dos painéis em perpendicular às vigas



2

Fixação do painel com três parafusos por cada apoio



3

Aplicação da massa pelo lado longitudinal e transversal do painel





THERMOCHIP

A Medua, s/n
32330 Sobradelo de Valdeorras, Ourense [España]
☎ +34 900 351 713 📠 +34 988 335 410

info@thermochip.com
www.thermochip.com

